



日本電子機械工業会技術レポート

Technical Report of Electronic Industries Association of Japan

EIAJ EDR-4702

**半導体デバイスの品質・信頼性試験方法
規格対照表**

**Standard comparison table of quality and reliability test
methods for semiconductor devices**

1996年3月制定

作成

半導体標準化委員会

Technical Standardization Committee on Semiconductor Devices

発行

社団法人 日本電子機械工業会
Electronic Industries Association of Japan

目 次

1. 半導体デバイスの品質・信頼性試験方法規格対照表	1
2. 引用規格一覧表 (表 1)	2
3. E I A J 規格と関連規格番号/章番号対照表 (表 2)	4
4. 試験方法名称対照表 (表 3)	7
5. 試験条件対照表	
環境試験 (機械的) (表 4. 1. 1 ~ 4. 1. 9)	25
環境試験 (耐候性) (表 4. 2. 1 ~ 4. 2. 13)	36
環境試験 (その他) (表 4. 3. 1 ~ 4. 3. 4)	50
耐久性試験 (デバイス毎) (表 4. 4. 1 ~ 4. 4. 9)	63
工程内評価 (観察) (表 4. 5. 1 ~ 4. 5. 6)	80
工程内評価 (機械的) (表 4. 6. 1 ~ 4. 6. 3)	86
解説	89
付録 (規格番号リスト)	
(1) E I A J 規格	93
(2) J I S 規格	99
(3) I E C 規格	102
(4) M I L 規格	116
(5) E I A / J E D E C 規格	120

日本電子機械工業会規格

半導体デバイスの品質・信頼性試験方法規格対照表

Standard comparison table of quality and
reliability test methods for semiconductor devices

1. 半導体デバイスの品質・信頼性試験方法規格対照表

1.1 適用範囲 この技術レポートは、日本電子機械工業会（以下、EIAJという。）規格、日本工業（以下、JISという。）規格、IEC規格、MIL規格、EIA/JEDEC規格などで取り決められている半導体デバイスの品質・信頼性試験規格の比較対照を示す。ここでは、EIAJ規格を基準にして関連する類似規格の比較を行っている。更に比較対照に引用した規格及び関連する規格を一覧に示す。この対照表には、JIS規格は95年度版JISハンドブック、MIL規格はMIL-STD-883D Notice 2 迄が取り込まれている。

1.2 品質・信頼性試験方法の分類 この技術レポートに記されている品質・信頼性試験は、EIAJ規格EIAJ ED-47××シリーズを参考に次のように分類される。

(1) 品質・信頼性試験

- (a) 環境試験（機械的）
- (b) 環境試験（耐候性）
- (c) 環境試験（その他）
- (d) 耐久性試験（デバイス毎）
- (e) 工程内評価（観察）
- (f) 工程内評価（機械的）

備考1. 試験規格の比較対照に引用した規格を「引用規格一覧表」として表1に示す。

- 2. EIAJ規格に定められた試験方法と、関連規格の該当する規格番号又は章番号を「EIAJ規格と関連規格番号／章番号対照表」として表2に示す。
- 3. 試験方法名称の比較対照を「試験方法名称対照表」として表3に示す。
- 4. これらの試験方法の試験条件の比較対照を「試験条件対照表」として表4に示す。この試験条件対照表は環境試験（機械的）（表4. 1. 1～9）、環境試験（耐候性）（表4. 2. 1～13）、環境試験（その他）（表4. 3. 1～4）、耐久性試験（デバイス毎）（表4. 4. 1～9）、工程内評価及（観察）（表4. 5. 1～6）、工程内評価（機械的）（表4. 6. 1～3）にて構成される。
- 5. 関連する規格の規格番号リストを最後に示す。

この技術レポートは各規格の対照表であり、試験条件の比較など詳細に行ってはいらぬもの、あくまで要点を抜粋した表に過ぎないので、これらの規格を実際に使用する場合には必ず原文の規格を見る必要がある。